

01 智慧財產及商業法院民事中間判決

02 113年度民專訴字第25號

03 原 告 義大利商技術探測股份有限公司  
04 (Technoprobe S. P. A)

05 法定代理人 Roberto Alessandro Crippa

06 訴訟代理人 王仁君律師

07 黃仁宜律師

08 複 代 理 人 沈建宏專利師

09 訴訟代理人 洪振盛律師

10 郁宗勳專利師

11 陳柏宇專利師

12 華奕超律師

13 黃珮茹律師

14 上列二人共

15 同複代理人 楊杰凱專利師

16 顏均宇專利師

17 林怡汝律師

18 被 告 中華精測科技股份有限公司

19 法 定

20 代 理 人 洪維國

21 訴訟代理人 蔡心雅律師

22 被 告 馬宏燦

23 訴訟代理人 康書懷律師

24 上二人共同

25 訴訟代理人 馮達發律師

26 鍾薰嫻律師

01 複代理人 蔡心雅律師

02 輔佐人 曹瑜玲

03 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院就中間爭  
04 點於民國115年3月3日言詞辯論終結，並為中間判決如下：

05 主 文

06 一、中華民國第I705249號「包含用於測試頭的複數個接觸式探  
07 針的半完成產品及相關製造方法」發明專利之專利權效力及  
08 於附件一探針半成品（即系爭產品1）。

09 二、附件一探針半成品（即系爭產品1）落入上開專利請求項1、  
10 17之專利權範圍。附件二探針半成品（即系爭產品2）未落  
11 入上開專利請求項1、17之專利權範圍。

12 三、上開專利請求項1、17之專利權並無應撤銷原因。

13 事實及理由

14 甲、程序方面：

15 壹、原告為外國法人，具有涉外因素，而為涉外民事事件。原告  
16 主張其受我國專利法保護之專利權遭被告侵害，侵權行為地  
17 於我國境內，且被告中華精測科技股份有限公司（下稱被告  
18 公司）之營業所所在地亦設於我國，參酌民事訴訟法第1條  
19 第1項、第2條第2項、第15條第1項、智慧財產及商業法院組  
20 織法第3條第1款及智慧財產案件審理法第9條第1項規定，本  
21 院具有國際管轄權，且本件準據法依涉外民事法律適用法第  
22 42條第1項、第25條規定，應適用我國法律。又原告為依外  
23 國法律設立之外國法人，於法令限制內，與中華民國公司有  
24 同一之權利能力，具有當事人能力。

25 貳、被告公司法定代理人變更為洪維國，兩造均具狀聲明承受訴  
26 訟，被告提出桃園市政府函文、被告公司變更登記表及委任  
27 狀為證（卷四第17至18頁、第109至125頁），核無不合，予  
28 以准許。

29 參、民事訴訟法第383條第1項規定：各種獨立之攻擊或防禦方  
30 法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決。請求之原

01 因及數額俱有爭執時，法院以其原因為正當者，亦同。原告  
02 主張被告公司所使用探針製造方法實現之半完成產品侵害其  
03 所有中華民國第I705249號「包含用於測試頭的複數個接觸  
04 式探針的半完成產品及相關製造方法」發明專利（下稱系爭  
05 專利），請求排除侵害及損害賠償。被告則抗辯系爭專利具  
06 有應撤銷原因，其所製造探針半成品未侵害系爭專利之專利  
07 權，且為系爭專利效力所不及。本院就下揭第參項一至三所  
08 列爭點，已達於可為裁判程度，爰先為中間判決。

09 乙、實體方面：

10 壹、原告主張：原告為系爭專利之專利權人，被告公司使用之探  
11 針製造方法侵害系爭專利，經本院證據保全（112年度民聲  
12 字第32號）取得之探針半成品（參附件一，下稱系爭產品  
13 1）以及被告揭露之探針半成品（參附件二，下稱系爭產品  
14 2）至少落入系爭專利請求項1、17之專利權範圍。系爭產品  
15 1之製造行為並非專利法第59條第1項第2款所稱以研究或實  
16 驗為目的實施發明之必要行為，被告提出之證據無法證明系  
17 爭產品1係以發明專利標的為對象之研究實驗。系爭專利請  
18 求項1、17具新穎性及進步性，並無被告所指應撤銷原因等  
19 情。

20 貳、被告則以：系爭專利於經濟部智慧財產局（下稱智慧局）實  
21 體審查期間進行請求項1、17之修正，修正內容未獲申請時  
22 原說明書支持，違反民國108年專利法第26條第2項規定，且  
23 系爭專利請求項1、17欠缺新穎性與進步性，具有應撤銷原  
24 因。系爭產品1、2及其製程並未侵害系爭專利請求項1、1  
25 7，系爭產品1係被告公司之試驗產品，應有專利法第59條第  
26 1項第2款規定之適用等情置辯。

27 參、本件爭點（秘保限閱卷二第383至384頁）：

28 一、系爭產品1是否為專利法第59條第1項第2款所稱之「以研究  
29 或實驗為目的實施發明之必要行為」，而為系爭專利之專利  
30 權效力所不及？

31 二、專利侵權部分：

01 (一)系爭產品1是否落入系爭專利請求項1、17之文義或均等範  
02 圍？

03 (二)系爭產品2是否落入系爭專利請求項1、17之文義或均等範  
04 圍？

05 三、專利有效性部分：

06 (一)系爭專利請求項1、17是否違反系爭專利核准審定時之專利  
07 法第26條第2項規定？

08 (二)乙證12是否足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性？

09 (三)乙證13是否足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性？

10 (四)乙證12、13之組合是否足以證明系爭專利請求項1、17不具  
11 進步性？

12 (五)乙證12、14之組合是否足以證明系爭專利請求項1、17不具  
13 進步性？

14 (六)乙證12、15之組合是否足以證明系爭專利請求項1、17不具  
15 進步性？

16 (七)乙證12、14、11之組合是否足以證明系爭專利請求項1、17  
17 不具進步性？

18 (八)乙證13、14之組合是否足以證明系爭專利請求項1、17不具  
19 進步性？

20 (九)乙證13、15之組合是否足以證明系爭專利請求項1、17不具  
21 進步性？

22 (十)乙證13、14、11之組合是否足以證明系爭專利請求項1、17  
23 不具進步性？

24 四、原告依專利法第96條第1項、第3項請求被告排除侵害，並依  
25 同法第96條第2項，民法第184條第1項、第179條及公司法第  
26 23條第2項規定請求被告負連帶賠償責任，有無理由？金額  
27 若干為適當？

28 肆、得心證理由：

29 一、系爭專利技術分析：

30 (一)技術內容：

01 系爭專利基礎上的解決方案將實現一種半完成產品，其中在  
02 半完成產品之基板中藉由自彼基板移除材料獲得許多接觸式  
03 探針，探針藉此實現為具有適宜機械連接橋以便將探針固持  
04 至基板，半完成產品因此能夠經歷一或更多個處理步驟，處  
05 理步驟影響半完成產品中所獲得之所有探針，直至獲得具有  
06 所欲特點的接觸式探針，此等探針隨後能夠與半完成產品之  
07 基板輕易分離（系爭專利說明書第[0030]段，卷二第15  
08 頁）。

09 (二)技術手段：

10 系爭專利描述一種包含用於電子裝置之測試頭的複數個接觸  
11 式探針（10）的半完成產品（15）之製造方法，此方法包含  
12 以下步驟：-提供由導電材料製成之基板（11）；以及-藉由  
13 自基板（11）移除材料界定接觸式探針（10）之各者，使得  
14 接觸式探針（10）之各者結果被至少一個材料橋（13）錨定  
15 至基板（11），界定接觸式探針（10）之彼步驟包含對應於  
16 接觸式探針（10）及至少一個材料橋（13）之輪廓的雷射切  
17 割步驟（系爭專利[發明摘要]，卷二第7頁）。

18 (三)申請專利範圍（主要圖式如附件三所示）：

19 系爭專利申請專利範圍共計17個請求項，其中請求項1、17  
20 為獨立項，其餘為附屬項。原告主張受侵害之系爭專利請求  
21 項1、17（以下請求項如未註記，係指「系爭專利請求  
22 項」）內容如下：

- 23 1.請求項1：一種包含用於電子裝置之一測試頭的複數個接觸  
24 式探針（10）的一半完成產品（15）之製造方法，該方法包  
25 含以下步驟：-提供由一導電材料製成之一基板（11）；以  
26 及-藉由自該基板（11）移除材料界定在一個別的框（12）  
27 內的該等接觸式探針（10）之各者，使得該等接觸式探針  
28 （10）之各者結果被至少一個個別的材料橋（13）錨定至圍  
29 繞該等接觸式探針（10）之各者的該個別的框（12），該界  
30 定該等接觸式探針（10）之步驟包含對應於該等接觸式探針

01 (10) 及該至少一個材料橋 (13) 之一輪廓的一雷射切割步  
02 驟。

03 2.請求項17：一種包含用於一測試頭的複數個接觸式探針 (1  
04 0) 的半完成產品 (15)，該等接觸式探針 (10) 之各者經  
05 實現於一導電材料之一基板 (11) 中之一個別的框 (12)  
06 內，且藉由至少一個別的材料橋 (13) 錨定至圍繞該等接觸  
07 式探針 (10) 之各者的該個別的框 (12)，該半完成產品  
08 (15) 經由如前述請求項中任何者所述之製造方法來實現。

09 二、系爭產品技術內容如附件一、二所示。

10 三、有效性證據分析：

11 (一)乙證11為西元2010年6月16日公開之中國大陸第CZ000000000  
12 A號「檢查用探針」專利公開案 (系爭專利審查階段引證4，  
13 主要圖式如附件四所示)。

14 (二)乙證12為西元2012年12月5至7日舉辦之會議G. Kimoto, T.  
15 Kakinuma, K. Doji, and N. Denda “Design and manufacture  
16 of noble probe card for testing 3D ICs with TSVs”,  
17 Electronics Packaging Technology Conference (EPTC),  
18 2012 (主要圖式如附件五所示)。

19 (三)乙證13為西元2002年1月29日公告之美國第US6343369B1號  
20 「METHODS FOR MAKING CONTACT DEVICE FOR MAKING CONNE  
21 CTION TO AN ELECTRONIC CIRCUIT DEVICE AND METHODS OF  
22 USING THE SAME」專利公告案 (主要圖式如附件六所示)。

23 (四)乙證14為西元2014年2月13日公開之美國第US2014/0044985  
24 A1號「PROBE FABRICATION USING COMBINED LASER AND MIC  
25 RO-FABRICATION TECHNOLOGIES」專利公開案 (系爭專利審  
26 查階段引證1，主要圖式如附件七所示)。

27 (五)乙證15為西元1998年12月18日公開之日本特開平第10-33274  
28 1號「プローブユニットの製造方法」專利案(主要圖式如附  
29 件八所示)。

30 (六)前揭證據之公開日或公告日皆早於系爭專利之優先權日 (西  
31 元2014年12月30日)，可為系爭專利之先前技術。

01 四、解釋申請專利範圍部分（已於114年6月16日發函通知兩造，  
02 卷三第41至42頁）：

03 (一)專利法第58條第4項規定：發明專利權範圍，以申請專利範  
04 圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。  
05 觀其立法理由，在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係  
06 屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保  
07 護範圍之內，惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範  
08 圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也  
09 不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，  
10 以瞭解其目的、作用及效果。又因說明書所載之申請專利範  
11 圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，如有未臻明確之  
12 處，自有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要，一般  
13 而言，為正確解釋申請專利範圍，尚得參酌內部證據與外部  
14 證據，並以內部證據為優先（最高行政法院104年度判字第3  
15 08號行政判決意旨參照）。

16 (二)請求項1部分：

17 1. 「個別的框」應解釋為藉由自基板移除材料所形成的凹槽，  
18 該凹槽的內側邊界所形成的實體框架：

19 (1)由系爭專利說明書第[0068]段揭露「在適宜凹槽中實現每個  
20 接觸式探針10，凹槽為實質方框狀，簡單指示為方框12，方  
21 框藉由移除材料而在基板11中實現且易於圍繞接觸式探針1  
22 0」，可知個別的框係由移除材料而在基板形成的凹槽，該  
23 凹槽形成圍繞接觸式探針的框，由圖式第3A圖所指之凹槽或  
24 圖式第3B圖所指之凹槽之內側邊界，其形成之方框，皆為圍  
25 繞接觸式探針的框，其意甚明，應無疑義。又系爭專利說明  
26 書第[0070]段為圖式第3A、3B圖之說明，揭露「每個接觸式  
27 探針10具有僅一個材料橋13，將此材料橋連接並錨定至相應  
28 方框12內部的基板11」，可知個別的框的內部即為基板，亦  
29 即個別的框係由凹槽所形成實體框架，該凹槽的內側邊界即  
30 為周圍基板。

01 (2)被告稱「系爭專利說明書明白區分『框』與『基板』為不同  
02 元件，以系爭專利說明書第3A圖為例，編號11為基板，而編  
03 號12則為框，且兩者標示位置不同。是以，系爭專利說明書  
04 清楚記載，『框』與『基板』分屬不同元件，不得混為一  
05 談」，且所謂「周圍」範圍有多廣有重大疑義云云(卷二第3  
06 94頁、卷三第5、6頁)。惟如前述，個別的框係由自基板移  
07 除材料所形成之凹槽，凹槽內側邊緣即基板的周圍而形成一  
08 實體框，故「框」即周圍基板，「框」與「基板」雖分屬不  
09 同元件，惟框之內緣即是周圍基板所形成之實體框，且個別  
10 的框係由凹槽所形成實體框架，故框之範圍即指凹槽所形成  
11 之框之內緣邊界，並無疑義。

12 (3)原告以系爭專利圖式第5A、7C圖說明，可涵蓋一根探針及複  
13 數根探針的框皆為「個別的框」，如附件九所示圖式第5A圖  
14 為例，各種顏色所圍繞探針之框皆為「個別的框」云云(卷  
15 二第444、445頁)。惟除涵蓋一根探針之框外皆非系爭專利  
16 所稱之「個別的框」，依據系爭專利說明書第[0068]段揭露  
17 「在適宜凹槽中實現每個接觸式探針10，凹槽為實質方框  
18 狀，簡單指示為方框12，方框藉由移除材料而在基板11中實  
19 現且易於圍繞接觸式探針10」，涵蓋複數根探針的框並非凹  
20 槽所形成實質方框狀，而是接觸式探針之間係以基板材料隔  
21 開，致使各自涵蓋一根探針之框與框斷開，未形成實質方框  
22 狀，況依通常知識認知，涵蓋複數根探針的框係為複數個  
23 框，強稱複數框為一個框，並不可採。

24 2. 「材料橋」應解釋為接觸式探針與個別的框之連接結構，可  
25 將接觸式探針錨定於個別的框：

26 (1)請求項1之技術特徵可解析為4個要件(各要件編號對應之技  
27 術特徵詳附件十二，以下「要件編號」省略，僅以編號稱  
28 之)。就文義解讀而言，請求項1之1C「使得該等接觸式探  
29 針(10)之各者結果被至少一個個別的材料橋(13)錨定至  
30 圍繞該等接觸式探針(10)之各者的該個別的框(12)」，  
31 其僅以「錨定」功能限定材料橋；由1D「該界定該等接觸式

01 探針(10)之步驟包含對應於該等接觸式探針(10)及該至  
02 少一個材料橋(13)之一輪廓的一雷射切割步驟」得知，材  
03 料橋之輪廓係由雷射切割而形成；因此，「材料橋」的連接  
04 結構只要達成錨定接觸式探針與個別的框已足，並無不明確  
05 之處，至於其詳細結構、材質、形狀、尺寸並未特別限定。

06 (2)被告稱「材料橋(13)」應解釋為「由供製作的原料，製作出的  
07 無最終功能性、具有短暫操作期間內連接與固定接觸式探  
08 針於框架上之功能，且外形像橋梁一樣的支撐結構，用以一  
09 端連接接觸式探針、另一端連接框架」云云(卷二第495、49  
10 6頁)。惟依據請求項中記載的用語明確，經參酌內部證據後  
11 所理解之通常意義，並無進一步限定材料橋除「錨定」以外  
12 之特定功能、外型結構，被告對於材料橋之限縮解釋不可  
13 採。

14 3.個別的框「圍繞」該等接觸式探針，其中「圍繞」應解釋為  
15 完整包圍，亦即個別的框「完整包圍」該等接觸式探針：

16 (1)系爭專利說明書雖未定義「圍繞」之義涵，惟系爭專利之圖  
17 式第3A、4A、5A、7C圖皆顯示個別的框完整包圍接觸式探  
18 針，參以原告於審查階段第二次申復書敘述先前技術未揭露  
19 「探針被對應的框所包圍」(卷一第266頁)，第二次審查意  
20 見所附之引證1至3，其探針周圍皆未顯示一封閉的框用以包  
21 圍探針，可知原告之第二次申復書亦肯認「圍繞」即指「完  
22 整包圍」。

23 (2)原告稱依最寬廣合理的解釋應包含「個別的框圍繞探針的一  
24 部分」云云(卷二第449、450頁)。惟被圍繞之標的物超出用  
25 以圍繞的框的範圍，無法以通常知識理解其係為「圍繞」，  
26 且參酌內部證據並無「圍繞探針的一部分」之技術特徵，故  
27 原告所稱之「圍繞探針的一部分」已實質擴大請求項範圍，  
28 並不足採。

29 4.「個別的框(12)」與「接觸式探針(10)」在數量上的對應關  
30 係應解釋為一對至少一之關係：

01 (1)有關「一個別的框(12)內的該等接觸式探針(10)之各  
02 者」，以文義而言，「個別的框」數量為一，「接觸式探  
03 針」數量為複數個，而「該等接觸式探針之各者」解釋上包  
04 含複數個接觸式探針之各別接觸式探針，亦即「各者」強調  
05 各自不同的個體，其屬於複數個接觸式探針，可為一個、複  
06 數個及所有的接觸式探針，惟各個皆為各自不同的個體；次  
07 從系爭專利請求項1得知，一個別的框係由自基板移除材料  
08 所界定，惟並未界定在基板上僅有一「個別的框」，故解釋  
09 上亦包括個別的框對應分群的複數個接觸式探針，而複數個  
10 接觸式探針各群的數量自可分為一至基板上複數個接觸式探  
11 針的總數量；由系爭專利說明書第[0094]段已揭露「界定步  
12 驟允許在具有任何形狀及尺寸的複數個方框12中實現複數個  
13 接觸式探針10」，故方框與接觸式探針的對應數量，包含一  
14 方框實現一個或多個接觸式探針，與前述解釋相符，且由說  
15 明書實施例皆為一對一的關係（系爭專利圖式第3A、4A、5A  
16 圖所揭露，卷二第53至55頁）亦可知系爭專利並未排除個別  
17 的框與接觸式探針為一對一之關係，因此，有關「一個別的  
18 框(12)內的該等接觸式探針(10)之各者」應解釋為「一  
19 個別的框(12)內的該等接觸式探針(10)之一或多個接觸  
20 式探針」為當。

21 (2)被告認為「個別的框(12)」與「接觸式探針(10)」於數量上  
22 的對應關係，應解釋為一對多(卷一第126、127頁，卷二第3  
23 52至358頁)，係依教育部《重編國語辭典修訂本》對「各」  
24 的解釋，其中「各」之釋意為「代」時，其意義為「一定群  
25 體中的不同個體本身」（卷二第361頁），同時具有群體性  
26 與單獨性，且依系爭專利說明書及申請歷史檔案，認定「個  
27 別的框」與「接觸式探針」之間數量上對應關係，應解釋為  
28 一對多，原告於審查歷程中已揭露一對多的關係，另以系爭  
29 專利申請時所送外文本用以論證其觀點云云(卷三第35頁)。  
30 惟原告於審查階段第一次申復書曾指出「引證1亦未暗示任  
31 何如本案所揭的製造半完成產品（即，在個別框架內具有多

01 個探針)，並且沒有其他現有技術文獻提出半完成產品的想  
02 法，半完成產品包括多個接觸式探針，每個接觸式探針限定  
03 在個別的框內並透過一材料橋連接」(卷一第266頁)，另於  
04 審查階段第二次申復書亦曾指出「每個個別的框圍繞每個接  
05 觸式探針」、「在個別框架內具有多個探針」(卷一第272  
06 頁)；由上得知，原告皆未於審查歷程中直接限縮框與探針  
07 為一對多的關係，其在申復書說明中雖提到「在個別框架內  
08 具有多個探針」，亦提到「每個接觸式探針限定在個別的框  
09 內」、「每個個別的框圍繞每個接觸式探針」，並未排除一  
10 對一之關係，故包含一對多及一對一之關係，縱有未臻明確  
11 之處，參考內部證據，系爭專利說明書揭露者包含一對一及  
12 一對多之關係；另被告同時認為依其解釋，則會有應撤銷事  
13 由(卷一第134至136頁，卷二第357、358頁)，然依解釋申  
14 請專利範圍應依「專利權有效性推定」，儘可能選擇不會使  
15 該專利權無效的解釋。故如上述，被告之解釋，排除「個別  
16 的框」與「接觸式探針」之間數量上一對一之關係，應不足  
17 採。另被告依據系爭專利申請時所送外文本藉以論證其論  
18 點，惟系爭專利請求項之解釋應以我國公告本為準，況外文  
19 本之請求項1並未限定「個別的框」，故尚無法證明系爭專  
20 利請求項1已排除個別的框與接觸式探針為一對一之對應關  
21 係。

22 5. 「使得該等接觸式探針(10)之各者結果被至少一個個別的材料橋(13)錨定至圍繞該等接觸式探針(10)之各者的該個  
23 別框(12)」，其中「材料橋」與個別的框、接觸式探針  
24 的連接結構應解釋為每一個接觸式探針都被至少一個個別專  
25 屬的材料橋錨定到圍繞該接觸式探針的個別的框：

27 (1) 「材料橋」的解釋已如前述，只要是經雷射切割形成可錨定  
28 接觸式探針及個別的框的連接結構皆屬之，故不論其係透過  
29 直接連接或間接連接而達成「錨定」功能者皆屬「材料  
30 橋」。其次，由文義解讀可知每一個接觸式探針都被至少一  
31 個個別專屬的材料橋錨定到圍繞該接觸式探針個別的框，其

01 係由解讀「各者」及「個別」得知，「接觸式探針之各者」  
02 即指「每一個接觸式探針」，亦即各別的接觸式探針皆有後  
03 續之技術特徵：「被至少一個個別的材料橋（13）錨定」，  
04 其中「個別」即單獨存在各自有別而專屬於各自之接觸式探  
05 針，故每一個各自的接觸式探針皆存在至少一個專屬的材料  
06 橋用以錨定，即該專屬的至少一個材料橋未與其他接觸式探  
07 針共用，故以文義解讀，其義甚明，至於除了被至少一個個  
08 別的材料橋錨定外，仍可存在其他非個別專屬的材料橋。

09 (2)原告稱依據請求項文字，「該等接觸式探針(10)之各者(亦  
10 即「所有的接觸式探針」)被材料橋錨定至框，所謂「個別  
11 的」對應關係應該是「框」與「材料橋」之間，並非「每一  
12 根接觸式探針彼此之間」，且只要能指出探針有被某個或某  
13 幾個材料橋錨定至框，即符合要求，非不可共用云云(卷三  
14 第26頁)。惟依文義解讀「接觸式探針之各者」被至少一個  
15 「個別的材料橋」錨定至「個別的框」，其對應關係顯然是  
16 接觸式探針與「個別的」材料橋，其義甚明。其次，既為  
17 「個別的」即表示各個有別，已如上述，該「至少一個個別  
18 的材料橋」自未與其他接觸式探針共用，原告所述不足採。

19 (3)原告稱以系爭專利說明書圖式第7C圖為例，一例為「綠色所  
20 示部分作為材料橋，用以連接接觸式探針與紅色所標記的個  
21 別的框，其中二根探針之間的綠色所示部分即為共用材料  
22 橋，使得探針結果被錨定至紅色所標記的個別的框」，如附  
23 件十圖示所示；另一例為「藍色所示部分為材料橋，藍色與  
24 綠色所示部分的材料橋用以連接接觸式探針與紅色所標記的  
25 個別的框，其中二根探針之間的綠色與藍色所示部分為共用  
26 材料橋，使得探針結果被錨定至紅色所標記的個別的框」，  
27 如附件十一圖示所示云云（卷三第27頁）。惟紅色框並非為  
28 移除基板材料之凹槽形成之實質方框狀，已如前述，故其非  
29 為「個別的框」，其次，藍色部分解釋為材料橋，且綠色部  
30 分除系爭專利所揭露之「材料橋」外，更擴大解釋將各原材  
31 料橋連接而橫跨基板而形成新的材料橋，無論是所稱藍色材

01 料橋或綠色材料橋，作成如此解釋，皆無所據，更已超出系  
02 爭專利說明書、申請專利範圍或圖式之範圍，故原告所稱系  
03 爭專利圖式明確包含共用材料橋的態樣，顯屬無據而不可  
04 採。

05 (4)被告稱「材料橋」與個別的框、接觸式探針的連接結構是  
06 「外形像橋梁一樣的支撐結構，用以一端連接接觸式探針、  
07 另一端連接框架」云云(卷二第495、496頁)。惟系爭專利請  
08 求項中記載的用語經解釋已臻明確，且經參酌內部證據後所  
09 理解之通常意義，並無進一步限定材料橋之特定連接結構，  
10 故被告對於請求項之限縮解釋，顯不足採。

11 (三)請求項17部分：

12 請求項17為物的請求項，係由請求項1之製法所實現之物，  
13 其中所爭執之技術特徵解釋與請求項1相同。

14 五、系爭專利之專利權效力及於系爭產品1：

15 被告辯稱系爭產品1屬於「以研究或實驗為目的實施發明之  
16 必要行為」，依專利法第59條第1項第2款規定，系爭專利之  
17 效力自不及於此，被告自無侵害系爭專利可言(秘保限閱卷  
18 一第84頁)，此為原告否認。經查：

19 (一)依專利法第59條第1項第2款規定，發明專利權之效力，不及  
20 於以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。觀其立法理  
21 由，規範研究實驗免責之目的，係保障以發明專利標的為對  
22 象之研究實驗行為，以促進發明之改良或創新，此等行為不  
23 須受「非營利目的」之限制；關於「實施發明之必要行為」  
24 涵蓋研究實驗行為本身及直接相關之製造、為販賣之要約、  
25 販賣、使用或進口等實施專利之行為，其手段與目的間必須  
26 符合比例原則，其範圍不得過於龐大，以免逸脫研究、實驗  
27 之目的，進而影響專利權人之經濟利益。

28 (二)被告所提證據無法證明系爭產品1符合「以研究或實驗為目  
29 的實施發明之必要行為」：

30 1.系爭產品1為被告所提附件B隨身碟之檔案(卷外證物袋)，其  
31 照片及影片顯示探針之半完成品，品名為「0000000000000000



01 究實驗行為，抑或促進系爭專利請求項1、17發明之改良或  
02 創新所在，均未充分說明或舉證，實不足以證明系爭產品1  
03 係針對系爭專利請求項1、17之「以研究或實驗為目的實施  
04 發明」的試驗行為。

05 (2)依據前揭CHPT-內部電子單據01、02顯示，其實驗數量為000  
06 00，單位不明確，被告稱其單位為「PCS」(秘保限閱卷二第  
07 9頁)，並舉證說明其製造過程皆以「針數」計算數量，如  
08 「LCN飛秒雷射操作指導書」第4頁系統介面顯示(秘保限閱  
09 卷二第479至480頁)，及乙證26之「MES生產系統體驗公證」  
10 (秘保限閱卷二第175至181頁)所顯示之入庫數量，因製造、  
11 入庫使用之系統互為勾稽，可推論其單位為「根」尚非無  
12 據。原告雖稱「LCN飛秒雷射操作指導書」，代表針之根數  
13 所用的單位符號為「pin」，另「自製針鍍膜檢驗規範」顯  
14 示「PCS」為「片」的單位(秘保限閱卷三第24至26頁)，惟  
15 由LCN飛秒雷射操作指導書0○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
16 ○○○○000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
18 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
20 飛秒雷射操作指導書」整體理解，已可推論其單位為  
21 「根」，僅由片段資訊尚難直接認定於雷射切割製造探針之  
22 製程中係以「片」為單位，併予敘明。

23 (3)被告稱「系爭產品屬於半導體晶圓測試用探針，屬於客製化  
24 產品」、「而系爭產品1乃是被告考量客戶需求而為之實驗  
25 性特殊設計探針，並採取雷射切割方式進行實驗，以評估該  
26 設計與製程實際功效，以為進一步改良」(秘保限閱卷二第1  
27 1頁)，被告針對系爭產品1試驗所提升產品性能，是否為後  
28 續商品化做準備，已屬可疑，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
29 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
30 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
31 是否逾越以研究或實驗為目的實施發明之「必要行為」，須以研究實驗行為之

01 標的為據，而系爭專利請求項1、17係用以製造接觸式探針  
02 之半完成產品，已如前述，故基於系爭專利請求項1、17發  
03 明之研究實驗，其製造數量自僅需符合其發明目的已足。系  
04 爭專利請求項1、17之主要技術特徵包含自基板雷射切割出  
05 個別的框及材料橋，並以材料橋將接觸式探針錨定至個別的  
06 框，故其研究實驗自應以如何完成前述之雷射切割步驟，並  
07 進一步改良，以通常知識者之一般實驗手段判斷，研究實驗  
08 系爭專利請求項1、17之發明○○○○○○00000○○○，被告  
09 雖稱○○00000○○○未逾越實施發明之必要行為，並以乙證2  
10 4(秘保限閱卷一第405至406頁)說明其每一探針卡所需探針  
11 數量需求由5千根至10萬根(秘保限閱卷二第481頁)，並稱  
12 「探針相關性能，包含本身之使用穩定性、常/高/低溫可靠  
13 度、群針一致性、接觸阻抗及再現性等，均需透過實際組裝  
14 成探針卡後，方得驗證其是否能發揮功能」、「其未組裝成  
15 探針卡以進行晶圓測試實驗時，要如何確認該研發中之探針  
16 具有實用性?可符合實際需求?在實際使用上，不會產生任何  
17 問題?是否具有再現性?結果是，最終仍不得不生產足供組裝  
18 一個探針卡之探針數量用以評估該探針設計與製程」(秘保  
19 限閱卷三第110至111頁)，然探針在組裝到探針卡之前的驗  
20 證，主要目標是確保其電性、機械特性、應力表現、對位精  
21 準之分析，可有效降低後續上機測試失敗的風險，並避免昂  
22 貴的探針卡因單一探針不良而需頻繁拆解維修，其屬於零件  
23 驗證，與探針安裝到探針卡進行晶圓測試之系統整合驗證不  
24 同，被告所稱之數量係用於探針卡，為探針卡之測試而非探  
25 針之測試，換言之，被告之測試行為係為組裝完成探針卡階  
26 段的整合測試，非為探針單體之測試，實已逾越以系爭專利  
27 請求項1、17發明為對象之研究實驗必要行為。

28 3. 依上說明，無法認定乙證23、23-1、26屬系爭產品1之專案  
29 製造資訊，無從證明系爭產品1為以研究或實驗為目的實施  
30 系爭專利請求項1、17之發明，縱認系爭產品1為試驗產品，  
31 亦係因應客戶需求進一步改進產品，為後續客製化商品之商



- 01 2.系爭產品1可進一步加工為探針，而係一種用於電子裝置之  
02 一測試頭之接觸式探針(圖1-1，秘保限閱卷一第22頁)，對  
03 應1A。
- 04 3.系爭產品1製程係使用○○○○為基板原材料，再經加工製  
05 程(秘保限閱卷一第18、19、22頁)，對應1B。
- 06 4.由圖1-2得知，系爭產品1具有個別的框，其係經雷射切割而  
07 成(秘保限閱卷一第18、22頁)，且如圖1-3、1-4所示，每一  
08 個個別的框內的接觸式探針，被個別的材料橋(圖1-3、1-  
09 4，黃色者為材料橋)錨定至圍繞複數個接觸式探針的個別的  
10 框，故系爭產品1之圖1-2、1-3、1-4所揭露已落入1C。
- 11 5.系爭產品1係以雷射設備直接於經減薄之原材料上切割形成  
12 探針之實體結構(秘保限閱卷一第18、19、22頁)，故已落入  
13 1D。
- 14 6.綜上所述，系爭產品1落入系爭專利請求項1之文義範圍，構  
15 成文義侵權。
- 16 7.被告稱系爭產品1未落入系爭專利請求項1之理由不可採：
- 17 (1)被告稱系爭產品1每組結構中，所形成之在最上、下邊緣之  
18 四方小孔係供對位，橫向之狹窄隙縫係供釋效應力，皆非  
19 「個別的框(12)」，如附件十四圖8所示，綠線標示者為藉  
20 由自基板移除材料所形成的凹槽的內側邊界所形成的實體框  
21 架，該實體框架並未「完整包圍」該等接觸式探針，接觸式  
22 探針至少有一側未受該實體框架包圍云云(秘保限閱卷二第4  
23 88至489頁)。惟查，被告稱「最上、下邊緣之四方小孔」、  
24 「橫向之狹窄隙縫」非「個別的框」，然依請求項解釋，  
25 「個別的框」應解釋為藉由自基板移除材料所形成的凹槽，  
26 該凹槽的內側邊界所形成的實體框架；故「最上、下邊緣之  
27 四方小孔」、「橫向之狹窄隙縫」其所形成之凹槽之內側邊  
28 界自可為「個別的框」之一部分，被告所稱並非可採；而被  
29 告將個別的框認定為細框架所形成之凹槽的內側邊界所形成  
30 的框，亦符合「個別的框」的解釋，惟其所稱「接觸式探針  
31 至少有一側未受該實體框架包圍」，顯不足採，依據請求項

01 解釋，「個別的框(12)」與「接觸式探針(10)」在數量上的  
02 對應關係應解釋為一對至少一之關係，故系爭產品1之個別  
03 的框顯已完整包圍複數個接觸式探針，被告對請求項解釋之  
04 認知容有誤謬，自非可採。

05 (2)被告稱系爭產品1之針尖與針尾兩側各設計有兩個支架，並  
06 隨同針尖、針頭一併切割下來，將此特殊規格之探針完成  
07 品，組裝於特殊測試頭，以進行量測。是以，針尖兩側支  
08 架、針尾兩側支架屬於探針完成品之一部分，而非作為接觸  
09 式探針與個別的框之連接結構，故不屬於系爭專利請求項  
10 1、17之「材料橋(13)」云云(秘保限閱卷二第491頁)。惟依  
11 請求項解釋，「材料橋」應解釋為接觸式探針與個別的框之  
12 連接結構，可將接觸式探針錨定於個別的框，故系爭產品1  
13 之針尖與針尾兩側支架為連接結構且可將接觸式探針錨定於  
14 個別的框，至為明顯，被告稱支架會隨同針尖、針頭一併切  
15 割下來，更顯示切割下來之前係為連接結構，其所稱非作為  
16 接觸式探針與個別的框之連接結構，顯無理由。

17 (3)因系爭產品1已落入請求項1之文義範圍，是否均等侵權無須  
18 論究。

19 (三)系爭產品1落入系爭專利請求項17文義範圍：

- 20 1.系爭專利請求項17技術特徵可解析為如附件十五所示3個要  
21 件(下以17A、17B、17C簡稱之)。
- 22 2.系爭產品1可進一步加工為探針，而係一種用於電子裝置之  
23 一測試頭之接觸式探針(圖1-1，秘保限閱卷一第22頁)，對  
24 應17A。
- 25 3.系爭產品1製程係使用○○○○為基板原材料，再經加工製  
26 程(秘保限閱卷一第18、19、22頁)；由圖1-2得知，系爭產  
27 品1具有個別的框，其係經雷射切割而成(秘保限閱卷一第1  
28 8、22頁)，且如圖1-3、1-4所示，每一個個別的框內的接觸  
29 式探針，被個別的材料橋(圖1-3、1-4，黃色者為材料橋)錨  
30 定至圍繞複數個接觸式探針的個別的框，故系爭產品1之圖1  
31 -2、1-3、1-4所揭露已落入17B。

01 4.依據前述請求項中任何者所述之製造方法(如前述系爭專利  
02 請求項1之製造方法)實現系爭產品1，故已落入17C。

03 5.綜上，系爭產品1落入系爭專利請求項17之文義範圍，構成  
04 文義侵權。

05 6.因系爭產品1已落入系爭專利請求項17之文義範圍，是否均  
06 等侵權無須論究。

07 (四)系爭產品2未落入系爭專利請求項1文義範圍及均等範圍：

08 1.系爭產品2圖式標註如附件十六所示。

09 2.系爭產品2包含複數個接觸式探針半成品，可進一步加工為  
10 探針，而係一種用於電子裝置之一測試頭之接觸式探針(圖1  
11 5，秘保限閱卷一第26、31頁)，可對應1A。

12 3.系爭產品2製程係使用○○○○為基板原材料，再經加工製  
13 程(秘保限閱卷一第28、31頁)，可對應1B。

14 4.系爭產品2具有個別的框，其係經雷射切割而成(圖15，秘保  
15 限閱卷一第26、31頁)，圍繞複數個接觸式探針，圖15上方  
16 標橫向條狀，為接觸式探針與個別的框之連接結構，故其為  
17 一材料橋，惟該材料橋為各個接觸式探針所共用，不具有  
18 「至少一個個別的材料橋錨定至個別的框」，故未落入1C。

19 5.系爭產品2係以雷射設備直接於經減薄之原材料上切割形成  
20 探針之實體結構(秘保限閱卷一第32頁)，故已落入1D。

21 6.綜上，系爭產品2因未具有「至少一個個別的材料橋錨定至  
22 個別的框」，故未落入系爭專利請求項1之文義範圍。且因  
23 系爭產品2未具備「至少一個別的材料橋」，而其共用之材  
24 料橋與個別的材料橋之結構不同，其達成錨定功能所使用之  
25 方式(way)具有實質差異，雖同樣可達成錨定之作用、功  
26 能，惟其使用不同之結構、方式，且明確於請求項中限定，  
27 二者之採用方式實質不同，不能認定二者為均等，故系爭產  
28 品2亦未落入系爭專利請求項1之均等範圍。

29 7.原告主張系爭產品2落入系爭專利請求項1專利權範圍不可採  
30 之理由：

01 (1)依原告主張之個別的框態樣3，稱其四側完整包圍至少一接  
02 觸式探針(秘保限閱卷三第32頁)，又稱「藉由自基板移除材  
03 料所形成的凹槽，該凹槽的內側邊界所形成的實體框架為紅  
04 色線條所示的凹槽內側邊界部分，其邊界呈不規則形」云云  
05 (秘保限閱卷三第31至32頁)。惟原告所稱邊界不規則之凹槽  
06 框，對個別的框態樣3圖式，其所繪製之紅色邊界，無法明  
07 確確定全部為切割出之凹槽，且原告所認知之兩探針之間所  
08 切割之紅色部分，已形成單獨塊狀，未與邊界連接，故原告  
09 主張無理由。既如上述，原告稱之個別的材料橋態樣3為接  
10 觸式探針之專屬材料橋(秘保限閱卷三第31至32頁)，自亦不  
11 可採。

12 (2)原告主張系爭產品2接觸式探針下方之黃色部分為個別的材料橋(態樣1)，惟被告主張系爭產品2之接觸式探針下方連接  
13 基板者為針尖(秘保限閱卷三第32至33頁)，原告稱因「將針  
14 尖直接連接基板，此會讓針尖的最頂端在探針與基板分離時  
15 非常容易受損，故被告之主張並不符常理」(秘保限閱卷一  
16 第74頁)；又主張系爭產品2之針尖以材料橋連接到框，被告  
17 所稱進一步研磨針尖，僅為將針尖殘留的材料橋去除(秘保  
18 限閱卷一第306頁)，復稱在磨掉之前即具備錨定探針至框之  
19 功能云云(秘保限閱卷三第33頁)。然依系爭產品2之顯微照  
20 片圖15(秘保限閱卷一第26頁)視之，並無明顯針尖及材料橋  
21 之區別，且系爭專利之針尖亦為雷射切割而成(系爭專利第3  
22 A圖)，被告所舉乙證21、22亦可證實務上須進一步研磨針尖  
23 (秘保限閱卷一第257頁)，故原告所為主張不足以證明被告  
24 所稱「以接觸式探針之一部分直接連接個別的框，不以額外  
25 之材料橋連接」為非，尚不足採。

26  
27 (3)原告稱材料橋雖是間接錨定到框，然為1C所均等讀取云云  
28 (秘保限閱卷一第79頁)。經查1C為「藉由自該基板(11)移  
29 除材料界定在一個別的框(12)內的該等接觸式探針(10)  
30 之各者，使得該等接觸式探針(10)之各者結果被至少一個  
31 個別的材料橋(13)錨定至圍繞該等接觸式探針(10)之各

01 者的該個別的框（12）」，系爭產品2不具有「至少一個個  
02 別的材料橋」，亦即各接觸式探針未具有至少一專屬材料橋  
03 用以錨定至個別的框，故未為系爭專利請求項1所文義讀  
04 取，已如前述，系爭產品2之材料橋為共用之材料橋，與系  
05 爭專利請求項1明確界定之限定條件不符，即其材料橋之結  
06 構不同，達成錨定功能所使用之方式(way)具有實質差異，  
07 雖同樣可達成錨定之作用、功能，惟其使用不同之結構、方  
08 式，且明確於請求項中限定，二者之採用方式實質不同，不  
09 能認定二者為均等，故系爭產品2未落入系爭專利請求項1之  
10 均等範圍。

11 (五)系爭產品2未落入系爭專利請求項17文義範圍及均等範圍：

- 12 1.系爭產品2包含複數個接觸式探針半成品，可進一步加工為  
13 探針，而係一種用於電子裝置之一測試頭之接觸式探針(圖1  
14 5，秘保限閱卷一第26、31頁)，已對應17A。
- 15 2.系爭產品2製程係使用○○○○為基板原材料，再經加工製  
16 程(秘保限閱卷一第28、31頁)，對應「一導電材料之一基  
17 板」；由圖15得知，系爭產品2具有個別的框，其係經雷射  
18 切割而成(秘保限閱卷一第26、31頁)，圍繞複數個接觸式探  
19 針，其具有一材料橋，為該材料橋為各個接觸式探針所共  
20 用，不具有至少一個個別的材料橋錨定至個別的框，故未落  
21 入17B。
- 22 3.依據前述請求項中任何者所述之製造方法(如前述系爭專利  
23 請求項1之製造方法)實現系爭產品1，故已對應17C。
- 24 4.綜上，系爭產品2因未具有至少一個個別的材料橋錨定至個  
25 別的材料橋，故未落入系爭專利請求項17之文義範圍。因系爭產  
26 品2未具備「至少一個別的材料橋」，而其共用之材料橋與  
27 個別的材料橋之結構不同，其達成錨定功能所使用之方式(w  
28 ay)具有實質差異，雖同樣可達成錨定之作用、功能，惟其  
29 使用不同之結構、方式，且明確於請求項中限定，二者之採  
30 用方式實質不同，不能認定二者為均等，故系爭產品2亦未  
31 落入系爭專利請求項17之均等範圍。

01 七、專利有效性部分：

02 系爭專利於109年6月11日經審定准予專利，有無撤銷原因應  
03 依108年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）論斷。

04 (一)系爭專利請求項1、17未違反核准時專利法第26條第2項之  
05 「請求項必須為說明書所支持」要件：

06 1.核准時專利法第26條第2項規定：申請專利範圍應界定申請  
07 專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明  
08 確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

09 2.被告稱原告於初審階段修正之技術特徵意指「在一實體框架  
10 結構內具有複數個接觸式探針（即，在實體框架結構內具有  
11 多個探針），而系爭專利說明書皆未見在一個框內具有多個  
12 接觸式探針的內容，而未獲說明書所支持云云（卷三第110至  
13 111頁）。惟有關「個別的框(12)」與「接觸式探針(10)」在  
14 數量上的對應關係應解釋為一對至少一之關係（卷三第41  
15 頁），其理由已如前述，故一個別的框內具有多個接觸式探  
16 針，未違反核准時專利法第26條第2項之「請求項必須為說  
17 明書所支持」要件。

18 (二)乙證12不足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性：

19 1.核准時專利法第22條第1項規定：可供產業上利用之發明，  
20 無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：申請前已  
21 見於刊物者。申請前已公開實施者。申請前已為公眾所  
22 知悉者。

23 2.乙證12與系爭專利請求項1之比對：

24 (1)1A：乙證12說明書第620頁右欄第1至15行及圖2揭露之鈹銅  
25 薄膜基板(mother Be-Cu thin film)上之複數個PPE(single  
26 -/multi-probe patterning element)的圖案，可比對請求  
27 項1「複數個接觸式探針的一半完成產品」之技術特徵；乙  
28 證12說明書第621頁右欄第1至6行及圖5，揭示用於全晶圓測  
29 試(卷二第166、167頁)，可對應請求項1「用於電子裝置之  
30 測試」之技術特徵。乙證12圖2揭露之PPE包含Probe contac  
31 t needles、Conductive signal patterns、Terminal need

01 les to substrates(卷二第166頁)，整體相當於接觸式探  
02 針，已揭露「用於電子裝置之一測試頭之接觸式探針」，故  
03 乙證12已揭露1A技術特徵。

04 (2)1B：乙證12說明書第620頁左欄第2至5行及圖2揭露之鈹銅薄  
05 膜基板包括多個PPE(卷二第166頁)，可對應請求項1之「基  
06 板(11)」，故乙證12已揭露1B技術特徵。

07 (3)1C：乙證12說明書第620頁右欄第4至6行及圖2揭露鈹銅薄膜  
08 基板上每個PPE形狀藉由雷射處理，並有一些薄材料橋(thin  
09 bridges)連接鈹銅薄膜基板，另於圖10(c)揭露，以雷射切  
10 割材料橋將PPE自鈹銅薄膜基板分離(卷二第166、169頁)。  
11 乙證12雖揭露PPE經雷射處理之形狀，其雖揭露薄材料橋(th  
12 in bridges)，惟該材料橋連接至PPE，並非用以連接接觸式  
13 探針，故其錨定PPE整體至個別的框，且接觸式探針亦未具  
14 有至少一專屬材料橋，故乙證12未揭露接觸式探針之各者被  
15 「至少一個個別的材料橋」錨定至個別的框，故乙證12未揭  
16 露1C技術特徵。

17 (4)1D：乙證12說明書第620頁右欄第4至6行及圖2揭露鈹銅薄膜  
18 基板藉由雷射處理形成PPE形狀，另圖10(c)揭露，以雷射切  
19 割薄材料橋將PPE自鈹銅薄膜基板分離(卷二第166、169  
20 頁)。乙證12說明書第620頁左欄第2至14行揭露藉由雷射處  
21 理製造Probe contact needle part、Terminal needle par  
22 t to the substrate、Conductive(signal) patterns(卷  
23 二第166頁)，已揭露切割出接觸式探針之輪廓，故乙證12  
24 已揭露1D技術特徵。

25 (5)綜上，乙證12未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，故  
26 乙證12不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。

27 3.乙證12與系爭專利請求項17之比對：

28 (1)17A：乙證12圖2揭露之PPE包含Probe contact needles、Co  
29 nductive signal patterns、Terminal needles to substr  
30 ates(卷二第166頁)，整體相當於接觸式探針，已揭露接觸  
31 式探針，故乙證12已揭露17A技術特徵。

01 (2)17B：乙證12說明書第620頁左欄第2至5行及圖2揭露之鈹銅  
02 薄膜基板包括多個PPE(卷二第166頁)，可對應「基板(1  
03 1)」，故乙證12已揭露請求項17之「一導電材料之一基板  
04 (11)」技術特徵。乙證12說明書第620頁右欄第4至6行及  
05 圖2揭露鈹銅薄膜基板上每個PPE形狀藉由雷射處理，並有一  
06 些薄材料橋(thin bridges)連接鈹銅薄膜基板，另於圖10  
07 (c)揭露，以雷射切割材料橋將PPE自鈹銅薄膜基板分離(卷  
08 二第166、169頁)。乙證12雖揭露PPE經雷射處理之形狀，其  
09 雖揭露薄材料橋(thin bridges)，惟該材料橋連接至PPE，  
10 並非用以連接接觸式探針，故其錨定PPE整體至個別的框，  
11 且接觸式探針亦未具有至少一專屬材料橋，乙證12未揭露接  
12 觸式探針之各者被「至少一個個別的材料橋」錨定至個別的  
13 框，故乙證12未揭露17B技術特徵。

14 (3)17C：乙證12未揭露請求項1之全部技術特徵，已如前述，因  
15 此乙證12亦未揭露17C技術特徵。

16 (4)綜上，乙證12未揭露系爭專利請求項17之全部技術特徵，故  
17 乙證12不足以證明系爭專利請求項17不具新穎性。

18 4.被告稱乙證12圖3、圖10(c)揭露四個材料橋，連接探針圖形  
19 化單元與實體框架云云(卷三第123、130、582至585頁)。惟  
20 被告所稱之四個材料橋為鄰接「Conductive signal patter  
21 ns」及「Non-conductive dummy patterns」之「Conductiv  
22 e dummy patterns」，顯非合理，乙證12說明書第620頁左  
23 欄第15至21行針對「Conductive dummy patterns」說明其  
24 係用以作為結構補強(reinforcements)及低漏電流結構(low  
25 leakage current structures)之用(卷二第166頁)，並非用  
26 以連接之用，況乙證12已明確揭露材料橋(thin bridges)，  
27 且依乙證12圖3所示，MPPS多探針圖形化薄片在未取下PPE前  
28 顯示PPE以材料橋(thin bridges)連接個別的框，被告所稱  
29 之四個材料橋已與個別的框分離，未用以錨定至個別的框，  
30 其用以對應系爭專利之材料橋顯非合理，因此被告所述無理  
31 由。

01 (三)乙證13不足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性：

02 1.乙證13與系爭專利請求項1之比對：

03 (1)1A：乙證13說明書第8欄第54至56行及圖6，揭示一個半導體  
04 測試設備用以測試電路裝置，其中電路裝置可對應請求項1  
05 之「電子裝置」；第8欄第15至41行及圖6揭示之指狀結構4  
06 8、導電線26及鎳凸塊34，可比對請求項1之「接觸式探  
07 針」；第13欄第49行至第14欄第8行，揭示不鏽鋼基板上的4  
08 個探針構件以解釋製程，相當於請求項1之「一半完成產品  
09 (15)之製造方法」(卷二第174、197、200頁)，故乙證13  
10 已揭露1A技術特徵。

11 (2)1B：乙證13說明書第13欄第49行至第14欄第8行及圖13(卷二  
12 第181、200頁)，其中基板300相當於請求項1之「提供由一  
13 導電材料製成之一基板(11)；以及」技術特徵，故乙證13  
14 已揭露1B技術特徵。

15 (3)1C：乙證13說明書第13欄第49行至第14欄第8行及圖13揭  
16 示，藉由雷射切割提供輪廓框314；第15欄第60行至第16欄  
17 第49行及圖15A、15B揭示，雷射切割指狀結構及輪廓框，以  
18 雷射切出縫合切口341並保留材料340，其材料340用以提供  
19 支撐探針構件346(卷二第181、183、200、201頁)；惟該輪  
20 廓框314未完整包圍導電線26及鎳凸塊34，故未揭露個別的  
21 框。第15欄第60行至第16欄第49行及圖15A、15B揭示「雷射  
22 切割指狀結構及輪廓框，以雷射切出縫合切口341並保留材  
23 料340，其材料340用以提供支撐探針構件346」，惟材料340  
24 並非用以連接接觸式探針，且接觸式探針亦未具有至少一專  
25 屬材料橋，而將接觸式探針錨定在個別的框，未揭示系爭專  
26 利之「被至少一個個別的材料橋(13)錨定」，故乙證13未  
27 揭露1C技術特徵。

28 (4)1D：乙證13說明書第15欄第60行至第16欄第49行及圖15A、1  
29 5B揭示，雷射切割指狀結構及輪廓框(卷二第183、201頁)，  
30 其中切割出指狀結構即相當於界定接觸式探針之輪廓，故已  
31 揭露1D技術特徵。

01 (5)綜上，乙證13未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵。故  
02 乙證13不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。

03 2.乙證13與系爭專利請求項17之比對：

04 (1)17A：乙證13說明書第8欄第15至41行及圖6揭示之指狀結構4  
05 8、導電線26及鎳凸塊34，可比對請求項17之「接觸式探  
06 針」；第13欄第49行至第14欄第8行，揭示不鏽鋼基板上的4  
07 個探針構件以解釋製程，相當於請求項17之「一半完成產品  
08 (15)」(卷二第174、197、200頁)，故乙證13已揭露17A技  
09 術特徵。

10 (2)17B：

11 ①乙證13說明書第13欄第49行至第14欄第8行及圖13，其中基  
12 板300(卷二第181、200頁)相當於請求項17之「基板」，故  
13 乙證13已揭露請求項17之「該等接觸式探針(10)之各者經  
14 實現於一導電材料之一基板(11)」技術特徵。

15 ②乙證13說明書第13欄第49行至第14欄第8行及圖13揭示，藉  
16 由雷射切割提供輪廓框314；乙證13說明書第15欄第60行至  
17 第16欄第49行及圖15A、15B揭示，雷射切割指狀結構及輪廓  
18 框，以雷射切出縫合切口341，其材料340用以提供支撐探針  
19 構件346(卷二第181、183、200、201頁)；惟該輪廓框314  
20 未完整包圍導電線26及鎳凸塊34，故未揭露個別的框。

21 ③乙證13說明書第15欄第60行至第16欄第49行及圖15A、15B揭  
22 示，雷射切割指狀結構及輪廓框，以雷射切出縫合切口341  
23 並保留材料340，其材料340用以提供支撐探針構件346，惟  
24 該輪廓框314未完整包圍導電線26及鎳凸塊34，故未揭露個  
25 別的框，且保留材料340亦非用以連接接觸式探針，接觸式  
26 探針更未具有至少一專屬材料橋，而將接觸式探針錨定在個  
27 別的框，故未揭示「藉由至少一個別的材料橋(13)錨定至  
28 圍繞該等接觸式探針(10)之各者的該個別的框(12)」。

29 ④如上所述，乙證13未揭露17B技術特徵。

30 (3)17C：乙證13未揭露請求項1之全部技術特徵，已如前述，因  
31 此乙證13亦未揭露17C技術特徵。

01 (4)綜上，乙證13未揭露系爭專利請求項17之全部技術特徵，故  
02 乙證13不足以證明系爭專利請求項17不具新穎性。

03 3.被告以乙證13比對系爭專利請求項1、17(卷三第131至156  
04 頁)不可採之理由：

05 (1)被告稱乙證13之指狀結構48比對接觸式探針云云(卷三第157  
06 頁)。惟依據通常知識，接觸式探針至少應包括接觸被測試  
07 晶圓之接觸端，確保穩定接觸之彈性結構及將電訊號由接觸  
08 端傳導至探針卡電路之導電路徑，故被告所稱指狀結構48不  
09 足以比對接觸式探針，應至少包括指狀結構48、導電線26及  
10 鍍凸塊34，故被告所述無理由。

11 (2)被告稱乙證13圖13及說明書第13欄第49行至第14欄第8行揭  
12 露之藉由自基板300移除材料所形成的凹槽，該凹槽的內側  
13 邊界所形成的實體框架之「輪廓框314」可比對系爭專利請  
14 求項1、17之「個別的框」。查乙證13相對於系爭專利請求  
15 項1、17之接觸式探針為指狀結構48、導電線26及鍍凸塊3  
16 4，故該輪廓框314並未完整包圍接觸式探針，故無法比對爭  
17 專利請求項1、17之「個別的框」，被告所述不足採。

18 (3)被告稱乙證13圖15A及說明書第15欄第60行至第16欄第49行  
19 之材料340，係為指狀結構與輪廓框之連接結構，可將指狀  
20 結構錨定於輪廓框云云(卷三第140、596、597頁)。惟乙證1  
21 3說明書第15欄第60行至第16欄第49行及圖15A、15B揭示，  
22 雷射切割指狀結構及輪廓框，以雷射切出縫合切口341並保  
23 留一些材料340，其材料340用以提供支撐探針構件346(卷二  
24 第183、201頁)，故可知材料340用以支撐(或連接)探針構  
25 件，並非是指狀結構(即相當於接觸式探針)與輪廓框之連接  
26 結構，且指狀結構亦欠缺專屬之材料橋錨定至輪廓框，故被  
27 告所述不可採。

28 (四)乙證12、13之組合不足以證明系爭專利請求項1、17不具進  
29 步性：

30 1.依核准時專利法第22條第2項規定，發明為其所屬技術領域  
31 中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不

01 得取得發明專利。

02 2.乙證12(主引證，卷三第576頁)未揭露系爭專利請求項1之全  
03 部技術特徵，乙證13亦未揭露系爭專利請求項1之全部技術  
04 特徵，已如前述。經查，乙證12、13皆未揭露接觸式探針之  
05 各者被至少一個個別材料橋錨定至個別的框，故乙證12、13  
06 皆未揭露請求項1之1C技術特徵。乙證12、13之組合不足以  
07 證明系爭專利請求項1不具進步性。

08 3.乙證12(主引證，卷三第576頁)未揭露系爭專利請求項17之  
09 全部技術特徵，乙證13亦未揭露系爭專利請求項17之全部技  
10 術特徵，已如前述。經查，乙證12、13皆未揭露接觸式探針  
11 之各者被至少一個個別材料橋錨定至個別的框，故皆未揭露  
12 系爭專利請求項17之17B技術特徵，同時亦皆未揭露17C技術  
13 特徵，已如前述。乙證12、13之組合不足以證明系爭專利請  
14 求項17不具進步性。

15 (五)乙證12、14之組合不足以證明系爭專利請求項1、17不具進  
16 步性：

17 1.乙證14與系爭專利請求項1之比對：

18 (1)1A：乙證14說明書第[0009]段及圖4揭示，一種探針的製造  
19 方法，包括：提供金屬箔；在金屬箔的邊緣形成尖端；以及  
20 使用雷射從金屬箔上切割出探針主體(卷二第212、213頁)，  
21 可知，乙證14用以製造探針半成品，且用於電子裝置之測試  
22 為發明所述技術領域之通常知識，故乙證14已揭露1A技術特  
23 徵。

24 (2)1B：乙證14說明書第[0009]段及圖4揭示之金屬箔12(卷二第  
25 212、213頁)相當於請求項1之「基板」，故乙證14已揭露1B  
26 技術特徵。

27 (3)1C：乙證14說明書第[0009]段揭示，使用雷射從金屬箔上切  
28 割出探針主體，並在該主體的一端形成一個或多個尖端(卷  
29 二第213頁)。惟其雷射切割形成之框未完整圍繞探針，故未  
30 揭露圍繞接觸式探針的個別的框，又乙證14亦未揭露「材料

01 橋」，故亦未揭露「錨定接觸式探針至個別的框的材料  
02 橋」。故乙證14未揭露1C技術特徵。

03 (4)1D：乙證14說明書第[0009]段揭示，使用雷射從金屬箔上切  
04 割出探針主體，並在該主體的一端形成一個或多個尖端(卷  
05 二第213頁)，惟未揭露雷射切割出材料橋，故乙證14未揭露  
06 1D技術特徵。

07 (5)綜上，乙證14未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵。

08 2.乙證12(主引證，卷三第576頁)未揭露請求項1之1C技術特  
09 徵，已如前述，乙證14亦未揭露請求項1之1C技術特徵；乙  
10 證12、14之組合仍未揭露系爭專利請求項1之全部技術特  
11 徵，故乙證12、14之組合不足以證明系爭專利請求項1不具  
12 進步性。

13 3.乙證14與系爭專利請求項17之比對：

14 (1)17A：乙證14說明書第[0009]段及圖4揭示，一種探針的製造  
15 方法，包括：提供金屬箔；在金屬箔的邊緣形成尖端；以及  
16 使用雷射從金屬箔上切割出探針主體(卷二第212、213頁)，  
17 可知，乙證14用以製造探針半成品，故乙證14已揭露17A技  
18 術特徵。

19 (2)17B：乙證14說明書第[0009]段及圖4揭示之金屬箔12(卷二  
20 第212、213頁)相當於請求項17之「基板」，故已揭露請求  
21 項17之「一導電材料之一基板」。乙證14說明書第[0009]段  
22 揭示，使用雷射從金屬箔上切割出探針主體，並在該主體的一  
23 端形成一個或多個尖端(卷二第213頁)，惟其雷射切割形  
24 成之框未完整圍繞探針，故未揭露圍繞接觸式探針的個別的  
25 框。另乙證14亦未揭露「材料橋」，亦未揭露「錨定接觸式  
26 探針至個別的框的材料橋」，故乙證14未揭露17B技術特  
27 徵。

28 (3)17C：乙證14未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，已如  
29 前述，因此乙證14亦未揭露17C技術特徵。

30 (4)綜上，乙證14未揭露系爭專利請求項17之全部技術特徵。

01 4.乙證12(主引證，卷三第576頁)未揭露請求項17之17B技術特  
02 徵，已如前述，乙證14亦未揭露請求項17之17B技術特徵；  
03 同時亦皆未揭露17C技術特徵，已如前述，乙證12、14之組  
04 合仍未揭露請求項17之全部技術特徵，故乙證12、14之組合  
05 不足以證明系爭專利請求項17不具進步性。

06 5.被告稱乙證14圖4框內的探針16之縮窄區段比對材料橋云云  
07 (卷三第188、599、600頁)。惟被告所稱之縮窄區段，於乙  
08 證14並未揭露其為「縮窄」或為「材料橋」之技術，亦未揭  
09 露其係用以連接或錨定接觸式探針，在欠缺明確揭露其功  
10 能、結構之前提下，僅以圖式即自行認定其為「材料橋」，  
11 顯不足採。

12 (六)乙證12、15之組合不足以證明系爭專利請求項1、17不具進  
13 步性：

14 1.乙證15與系爭專利請求項1之比對：

15 (1)1A：乙證15為一種製造薄膜狀探針單元的方法，說明書第[0  
16 002]段揭示，用於半導體晶圓上的積體電路、從半導體晶圓  
17 分離成晶片之積體電路及已裝配於晶片上之積體電路進行測  
18 試所使用之探針板、探針卡或此類之檢測機台或測試頭；其  
19 中積體電路、晶片比對請求項1之「電子裝置」；第[002  
20 0]、[0022]段及圖1(A)揭示「指狀探針區域24」及導電線3  
21 2，可比對請求項1之「接觸式探針」；第[0027]段、圖2(A)  
22 揭示，顯為一半成品(卷二第216、217、218、220頁)，故乙  
23 證15已揭露1A技術特徵。

24 (2)1B：乙證15說明書第[0025]、[0027]段、圖2(A)、2(B)揭示  
25 之「基底金屬材料40」(卷二第218、220頁)相當於請求項1  
26 之「基板」，故乙證15已揭露1B技術特徵。

27 (3)1C：乙證15圖2(A)及說明書第[0038]段揭露之藉由自不銹鋼  
28 金屬材料40以雷射切割步驟移除材料所形成的切縫46與凹槽  
29 48之內側邊界所形成之框，惟該框未完整包圍指狀探針區域  
30 24、導電線32及突出部34，即未完整包圍接觸式探針，故未

01 揭露個別的框，又乙證15未揭示材料橋，故乙證15未揭露1C  
02 技術特徵。

03 (4)1D：乙證15說明書第[0028]、[0029]段及圖2(A)揭示透過蝕  
04 刻形成凹陷區域44(卷二第218、220頁)，並非由雷射切割，  
05 且未揭示材料橋，故乙證15未揭露1D技術特徵。

06 (5)綜上，乙證15未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵。

07 2.乙證12(主引證，卷三第576頁)未揭露請求項1之1C技術特  
08 徵，已如前述，乙證15亦未揭露請求項1之1C技術特徵，乙  
09 證12、15之組合仍未揭露請求項1之全部技術特徵，故乙證1  
10 2、15之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

11 3.乙證15與系爭專利請求項17之比對：

12 (1)17A：乙證15為一種製造薄膜狀探針單元的方法，說明書第  
13 [0020]、[0022]段及圖1(A)揭示「指狀探針區域24」及導電  
14 線32，可比對請求項17之「接觸式探針」；第[0027]段、圖  
15 2(A)揭示，顯為一半成品(卷二第216、217、218、220  
16 頁)，故乙證15已揭露17A技術特徵。

17 (2)17B：乙證15說明書第[0025]、[0027]段、圖2(A)、2(B)揭  
18 示之「基底金屬材料40」(卷二第218、220頁)相當於請求項  
19 17之「基板」，故已揭露請求項17之「一導電材料之一基  
20 板」；乙證15圖2(A)及說明書第[0038]段揭露之藉由自不銹  
21 鋼金屬材料40以雷射切割步驟移除材料所形成的切縫46與凹  
22 槽48之內側邊界所形成之框，惟該框未完整包圍指狀探針區  
23 域24、導電線32及突出部34，即未完整包圍接觸式探針，故  
24 未揭露個別的框，又乙證15未揭示材料橋，故乙證15未揭露  
25 17B技術特徵。

26 (3)17C：乙證15未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，已如  
27 前述，因此乙證15亦未揭露17C技術特徵。

28 (4)綜上，乙證15未揭露系爭專利請求項17之全部技術特徵。

29 4.乙證12(主引證，卷三第576頁)未揭露系爭專利請求項17之1  
30 7B技術特徵，已如前述，乙證15亦未揭露17B技術特徵；同  
31 時亦皆未揭露17C技術特徵，已如前述；故乙證12、15之組

01 合仍未揭露請求項17之全部技術特徵，故乙證12、15之組合  
02 不足以證明系爭專利請求項17不具進步性。

03 5.被告以乙證15比對系爭專利請求項1、17(卷三第197至212  
04 頁)，不可採之理由：

05 (1)被告稱乙證15之圖1、圖2(A)及說明書第[0020]、[0027]段  
06 揭示之探針單元包括多個細長指狀探針區域24，其中多個細  
07 長指狀探針區域24比對系爭專利請求項1、17之接觸式探針  
08 云云(卷三第197頁)。惟依據通常知識，接觸式探針至少應  
09 包括接觸被測試晶圓之接觸端，確保穩定接觸之彈性結構及  
10 將電訊號由接觸端傳導至探針卡電路之導電路徑，故被告所  
11 稱多個細長指狀探針區域24不足以比對接觸式探針，應至少  
12 包括指狀探針區域24、導電線32及突出部34，故被告所述無  
13 理由。

14 (2)被告稱乙證15揭露藉由自該基板40移除材料界定在一個別的  
15 框內的該等接觸式探針區域24之各者，以雷射切割步驟移除  
16 材料所形成的切縫46與凹槽48，切縫46與凹槽48的內側邊界  
17 所形成的實體框架之個別的框云云(卷三第201、202頁)。惟  
18 被告所稱之個別的框為搭配乙證15圖7及圖2之切縫46與凹槽  
19 48的內側邊界所形成的實體框架，其所框出者為細長指狀之  
20 輪廓，惟該框未完整包圍指狀探針區域24、導電線32及突出  
21 部34，即未完整包圍接觸式探針，因未形成一完整包圍之  
22 框，故未揭露個別的框，被告所述不足採。

23 (3)被告稱乙證15圖2(B)顯示之局部不銹鋼底金屬材料40可比對  
24 材料橋云云(卷三第202頁)。惟基底金屬材料40作為製造薄  
25 膜狀探針單元之基底材料即為明顯，非可比為材料橋，被告  
26 所述無理由。

27 (4)被告稱乙證15說明書第[0038]段界定切除凹槽48之一輪廓的  
28 一雷射切割步驟云云(卷三第206頁)。惟其所稱之雷射切割  
29 步驟係應用於形成切縫46及凹槽48，且係由可切割如聚醯亞  
30 胺等合成樹脂的低功率雷射切割(乙證15說明書第[0039])

01 段，卷二第218、219頁)，並非用以切割金屬材質之基板，  
02 被告所述不足採。

03 (七)乙證12、14、11之組合不足以證明系爭專利請求項1、17不  
04 具進步性：

05 1.乙證11與系爭專利請求項1之比對：

06 (1)1A：乙證11說明書第[0001]段揭示「本發明涉及使觸頭與形  
07 成在檢查基板上的電路圖案接觸以對該電路圖案進行檢查的  
08 檢查用探針」(卷一第316頁)，其中「檢查基板上的電路圖  
09 案」，其「電路圖案」相當於請求項1之「電子裝置」，其  
10 形成在檢查基板上之檢查用探針即為接觸式探針之半完成產  
11 品，故乙證11已揭露1A技術特徵。

12 (2)1B：乙證11說明書第[0052]段、圖3揭示導電性的板狀部件3  
13 0(卷一第319、325頁)比對請求項1之「基板」，故乙證11已  
14 揭露1B技術特徵。

15 (3)1C：乙證11說明書第[0053]、[0055]段及圖3、4揭露，由板  
16 狀部件30切下多個檢查用探針10及枝狀部分34、36，及探針  
17 連結體40包含框架32；第[0059]、[0060]、[0074]段及圖5  
18 A、5B揭示連接部52連接之枝狀部分36，並通過切斷連接部5  
19 2而將多個檢查用探針從框架32分開，故連接部52相當於請  
20 求項1之「材料橋」，且各自有專屬之連接部52連結至框架  
21 (卷一第319、320、321、325、326頁)。乙證11雖揭示經切  
22 下檢查用探針10及枝狀部分34、36，而具有框架32，惟其框  
23 架並非是完整圍繞接觸式探針的框，未對應請求項1之「一  
24 個別的框(12)」及「圍繞該等接觸式探針(10)之各者的  
25 該個別的框(12)」技術特徵，故乙證11未揭露1C技術特  
26 徵。

27 (4)1D：乙證11說明書第[0053]段及圖3揭示，利用蝕刻形成檢  
28 查用探針及框架(卷一第319、325頁)，並未揭露一雷射切割  
29 步驟，乙證11未揭露1D技術特徵。

30 (5)綜上，乙證11未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵。

01 2.乙證12(主引證，卷三第576頁)、14之組合皆未揭露請求項1  
02 之1C技術特徵，已如前述，乙證11亦未揭露1C技術特徵，故  
03 乙證12、14、11之組合仍未揭露系爭專利請求項1之全部技  
04 術特徵，故乙證12、14、11之組合不足以證明系爭專利請求  
05 項1不具進步性。

06 3.乙證11與系爭專利請求項17之比對：

07 (1)17A：乙證11說明書第[0001]段揭示「本發明涉及使觸頭與  
08 形成在檢查基板上的電路圖案接觸以對該電路圖案進行檢查  
09 的檢查用探針」(卷一第316頁)，其中形成在檢查基板上之  
10 檢查用探針即為接觸式探針之半完成產品，故乙證11已揭露  
11 17A技術特徵。

12 (2)17B：乙證11說明書第[0052]段、圖3揭示導電性的板狀部件  
13 30比對請求項1之「基板」；第[0053]、[0055]段及圖3、4  
14 揭露，由板狀部件30切下多個檢查用探針10及枝狀部分34、  
15 36，及探針連結體40包含框架32；第[0059]、[0060]、[007  
16 4]段及圖5A、5B揭示連接部52連接之枝狀部分36，並通過切  
17 斷連接部52而將多個檢查用探針從框架32分開，故連接部52  
18 相當於請求項17之「材料橋」，且各自有專屬之連接部52連  
19 結至框架(卷一第319、320、321、325、326頁)。乙證11雖  
20 揭示經切下檢查用探針10及枝狀部分34、36，而具有框架3  
21 2，惟其框架並非是完整圍繞接觸式探針的框，故未對應請  
22 求項17之「一個別的框(12)」及「圍繞該等接觸式探針  
23 (10)之各者的該個別的框(12)」技術特徵，乙證11未揭  
24 露17B技術特徵。

25 (3)17C：乙證11未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，已如  
26 前述，因此乙證11亦未揭露17C技術特徵。

27 (4)綜上，乙證11未揭露系爭專利請求項17之全部技術特徵。

28 4.乙證12(主引證，卷三第576頁)、14之組合未揭露請求項17  
29 之17B技術特徵，已如前述，乙證11亦未揭露17B技術特徵；  
30 同時亦皆未揭露17C技術特徵，已如前述，乙證12、14、11

01 之組合仍未揭露請求項17之全部技術特徵，故乙證12、14、  
02 11之組合不足以證明系爭專利請求項17不具進步性。

03 5.被告稱乙證11圖4、說明書第[0034]段、第[0055]段之框架3  
04 2與一部分枝狀部分34、36形成的實體框架係包圍檢查用探  
05 針10的兩端(包括尖端部12)，與乙證14之除了針尖處之外，  
06 包圍探針16之實體框架組合，而簡單變更外型為完整包圍接  
07 觸式探針之實體框架，無不可預期之功效，乃系爭專利之發  
08 明所屬技術領域中具有通常知識者得以參酌乙證14之揭露內  
09 容而輕易完成者，且系爭專利於審查階段曾引用乙證14、11  
10 之組合，認為系爭專利請求項1與17不具進步性云云(卷三第  
11 115、277頁)。被告所稱乙證11之框架已圍住尖端部12，而  
12 乙證14之框架除針尖處均包圍探針16，故可組合成完整包圍  
13 之實體框架，然查系爭專利經審查後核准公告，被告以審查  
14 過程中曾認系爭專利應不具進步性，已無理由，況被告所稱  
15 之乙證14、11並非因應圍繞接觸式探針之個別的框之技術差  
16 異而組合，故被告引用審查階段之理由，並無根據。其次，  
17 乙證11、14皆非完整圍繞接觸式探針之框，系爭專利請求項  
18 1、17之技術特徵既解釋為完整圍繞接觸式探針之個別的  
19 框，其即為一完整之技術特徵，僅以乙證11之尖端部被圍  
20 繞，而乙證14之針尖處未被圍繞，即認定可組成一完整之  
21 技術特徵，將一完整之技術特徵拆解，再以乙證11、14刻意  
22 搭湊，其組合顯無理由，況乙證11、14之框架有明顯之差  
23 異，尚難逕以組成一完整圍繞之框架，故被告所稱不足  
24 採。

25 (八)乙證13、14之組合不足以證明系爭專利請求項1、17不具進  
26 步性：

27 1.乙證13(主引證，卷三第576頁)未揭露請求項1之全部技術特  
28 徵，乙證14未揭露請求項1之全部技術特徵，已如前述，乙  
29 證13、14皆未揭露請求項1之1C技術特徵，故乙證13、14之  
30 組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

01 2.乙證13(主引證，卷三第576頁)未揭露請求項17之全部技術  
02 特徵，乙證14未揭露請求項17之全部技術特徵，已如前述，  
03 乙證13、14皆未揭露請求項17之17B、17C技術特徵，故乙證  
04 13、14之組合不足以證明系爭專利請求項17不具進步性。

05 (九)乙證13、15之組合不足以證明系爭專利請求項1、17不具進  
06 步性：

07 1.乙證13(主引證，卷三第576頁)未揭露請求項1之全部技術特  
08 徵，乙證15未揭露請求項1之全部技術特徵，已如前述，乙  
09 證13、15皆未揭露請求項1之1C技術特徵，故乙證13、15之  
10 組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

11 2.乙證13(主引證，卷三第576頁)未揭露請求項17之全部技術  
12 特徵，乙證15未揭露請求項17之全部技術特徵，已如前述，  
13 乙證13、15皆未揭露請求項17之17B、17C技術特徵，亦如前  
14 述，故乙證13、15之組合不足以證明系爭專利請求項17不具  
15 進步性。

16 (十)乙證13、14、11之組合不足以證明系爭專利請求項1、17不  
17 具進步性：

18 1.以乙證13為主引證(卷三第576頁)；乙證11未揭露請求項1之  
19 全部技術特徵，乙證13、14之組合未揭露請求項1之全部技  
20 術特徵，已如前述，乙證13、14、11皆未揭露請求項1之1C  
21 技術特徵，故乙證13、14、11之組合不足以證明系爭專利請  
22 求項1不具進步性。

23 2.以乙證13為主引證(卷三第576頁)；乙證11未揭露請求項17  
24 之全部技術特徵，乙證13、14之組合未揭露請求項17之全部  
25 技術特徵，已如前述，乙證13、14、11皆未揭露請求項17之  
26 17B技術特徵，同時亦皆未揭露17C技術特徵，已如前述，故  
27 乙證13、14、11之組合不足以證明系爭專利請求項17不具進  
28 步性。

29 伍、綜上所述，系爭專利之專利權效力及於系爭產品1；系爭產  
30 品1落入系爭專利請求項1、17之專利權範圍；系爭產品2未  
31 落入系爭專利請求項1、17之文義及均等範圍；系爭專利請

01 求項1、17之專利權並無應撤銷原因。從而，本件關於系爭  
02 產品1之排除侵害及損害賠償請求，須進一步審理，並以上  
03 開判斷為前提，爰為中間判決如主文。

04 陸、兩造其餘有關爭點一至三之攻擊或防禦方法，及未經援用之  
05 證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自  
06 無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

07 中 華 民 國 115 年 4 月 2 日

08 智慧財產第一庭

09 法 官 陳端宜

10 以上正本係照原本作成。

11 本中間判決不得獨立提起上訴。

12 中 華 民 國 115 年 4 月 13 日

13 書記官 吳祉瑩